

企业需求信息	
需求名称	无
产业领域	电子信息
主要产品	无
企业名称	沈阳中光电子有限公司
属 地	铁西区
技术难题	产品技术方面： 1、公司的编码器产品技术处于优势地位，间接服务于新松、汇川、禹衡、等著名工业自动化企业。属于国家工业自动化的不可或缺的核心器件。 2、公司计划扩大集成电路设计开发，解决中国半导体行业长久以来的缺乏核“芯”的问题。 设备技术方面： 1、晶元级圆片封装技术：以圆片为加工对象，在圆片上同时对众多芯片进行封装、老化、测试，最后切割成单个器件，可以直接贴装到基板或印刷电路板上。它使封装尺寸减小至IC 芯片的尺寸，生产成本大幅度下降。 2、COB封装技术：是将裸芯片是芯片主体和I/O端子在晶体上方，在焊接时将此裸芯片用导电/导热胶粘接在PCB上，凝固后，用 Bonder 机将金属丝 (Al或Au) 在超声、热压的作用下，分别连接在芯片的I/O端子焊区和PCB相对应的焊盘上，测试合格后，再封上树脂胶。 3、等离子清洗技术：能够改善材料表面的润湿能力，使多种材料能够进行涂覆、涂镀等操作，增强粘合力、键合力，同时去除有机污染物、油污或油脂。 4、自动封装技术：主要用于集成电路和半导体器件的后工序封装，系统集成上片、上料、预热、装料、清模、去胶、收料于一体，大大提高了封装

	效率和封装质量。是一种适用于2-8个条带的，高产出模块化的自动封装系统。 5、AUTO INLINE技术：将手动工装的几个工序通过制作非标自动化设备整合在一起，大幅度的提高生产效率，减少作业人员
企业简介	无
人才引进	1、电子设计方面，学历本科以上8名； 2、电气视觉方面，学历本科以上5名； 3、编码器研发方面，学历本科以上6名； 4、光电IC设计方面，学历硕士以上6名； 5、AI算法方面，学历硕士以上5名。
科技金融	无
知识产权等需求	无
项目负责人	徐波
电 话	89724545